

經濟部公告

中華民國111年1月27日

經授貿字第11140005410號

主 旨：預告修正「限制輸出貨品表」，CCC8486.10.00.20-1「供半導體晶圓製程用之磨光、拋光及研磨機器」等17項貨品修正輸出規定代號「488」內容。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：經濟部。

二、修正依據：貿易法第十一條第二項。

三、基於管理及產業需求，爰公告修正旨揭貨品輸出規定代號「488」內容（詳附件）。本案另載於本部國際貿易局經貿資訊網（網址：<https://www.trade.gov.tw>），及經濟部主管法規查詢系統／草案預告論壇（網址：<https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx>）（或由「經濟部全球資訊網首頁／法規及訴願／草案預告」可連結本網頁）。

四、對公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起60日內陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：經濟部國際貿易局

（二）地址：臺北市湖口街1號

（三）電話：02-23977393

（四）傳真：02-23217736

（五）電子郵件：boft@trade.gov.tw

部 長 王美花

「限制輸出貨品表」
貨品輸出規定變更明細表

貨品號列	貨 名	原 列	改 列
		輸出規定	輸出規定
8486.10.00.20-1	供半導體晶圓製程用之磨光、拋光及研磨機器	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03
8486.20.00.11-0	生產半導體用化學氣相沈積器具	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03
8486.20.00.12-9	製造半導體用之物理氣相沈積器具	121	121
		488	488*
8486.20.00.31-6	供半導體材料乾式蝕刻圖形工具機	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03
8486.20.00.32-5	供蝕刻、去除光阻物或清洗半導體晶圓之噴灑機具	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03
8486.20.00.33-4	供濕蝕刻、顯影、去除光阻物或清洗半導體晶圓之器具	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03

8486.20.00.40-5	半導體晶圓磊晶沈積機	121 488*	121 488*
8486.20.00.50-2	供摻雜半導體材料之離子植入器	121 488 541 S01 S03	121 488* 541 S01 S03
8486.20.00.61-9	生產半導體晶圓用之步進及重複對準機	121 488 S01 S03 121 488*	121 488 S01 S03 121 488*
8486.20.00.62-8	生產半導體晶圓用之掃描對準機	121 488 S01 S03 121 488*	121 488 S01 S03 121 488*
8486.20.00.63-7	電子束直接寫入晶圓器具	121 488 S01 S03 121 488*	121 488 S01 S03 121 488*
8486.20.00.71-7	半導體晶圓加工用旋轉乾燥機	121 488 S01 S03 121 488*	121 488 S01 S03 121 488*
8486.20.00.72-6	供感光劑塗附在半導體晶圓上之旋轉器	121 488 121 488*	121 488 121 488*
8486.20.00.73-5	製造半導體晶圓用之光阻塗佈器具	121 488	121 488*

8486.20.00.80-6	供半導體晶圓氧化、擴散或回火用之快速加熱器具	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03
9031.41.10.10-2	附有專供半導體晶圓或網線上下料及傳送設備用之顯微照相顯微鏡	121	121
		488	488*
9031.80.00.20-4	附有專供半導體晶圓或網線上下料及傳送設備用之電子束顯微鏡	121	121
		488	488*
		S01	S01
		S03	S03

號列項數: 17

輸出規定代號說明

121	由貿易局簽發輸出許可證。
488	一、輸出化學機械研磨機、光阻剝除機、光阻顯影機、快速高溫熱處理機、沉積設備、洗淨設備、乾燥機、電子顯微鏡、蝕刻機、離子植入機、光阻塗佈機、微影設備等十二類半導體晶圓製造設備，應檢附下列文件申請輸出許可證，出口人並應於輸出許可證列明所生產之晶圓尺寸及製程技術水準；違者，應自負相關法律責任：（一）輸往大陸地區者，如屬投資行為，應檢附經濟部投資審議委員會核准投資文件；如非投資行為，應檢附非投資行為之切結書。輸往大陸以外地區者，應檢附保證不以輸出許可證上所載貨品投資大陸地區之切結書。（二）屬戰略性高科技貨品列管項目者，除應檢附上述文件外，應另依戰略性高科技貨品輸出入管理辦法相關規定辦理。二、輸出非屬上述十二類半導體晶圓製造設備者，應檢附經濟部國際貿易局出具之鑑定報告。三、保稅區或課稅區或自由貿易港區間之半導體晶圓製造設備移轉，免辦理輸出許可證。

488*

一、輸出化學機械研磨機、光阻剝除機、光阻顯影機、快速高溫熱處理機、沉積設備、洗淨設備、乾燥機、電子顯微鏡、蝕刻機、離子植入機、光阻塗佈機、微影設備等十二類半導體晶圓製造設備，應檢附下列文件申請輸出許可證，出口人並應於輸出許可證列明所生產之晶圓尺寸及製程技術水準；違者，應自負相關法律責任：（一）輸往大陸地區者，如屬投資行為者，應檢附經濟部投資審議委員會核准投資文件；如非投資行為者，應檢附非投資行為之切結書。輸往大陸以外地區者，應檢附保證不以輸出許可證上所載貨品投資大陸地區之切結書。（二）輸出 C C C 8 4 8 6 2 0 0 0 4 0 - 5 「半導體晶圓磊晶沉積機」、C C C 8 4 8 6 2 0 0 0 5 0 - 2 「供摻雜半導體材料之離子植入器」、C C C 8 4 8 6 2 0 0 0 6 1 - 9 「生產半導體晶圓用之步進及重複對準機」、C C C 8 4 8 6 2 0 0 0 6 2 - 8 「生產半導體晶圓用之掃描對準機」及 C C C 8 4 8 6 2 0 0 0 6 3 - 7 「電子束直接寫入晶圓器具」等 5 個貨品分類號列項下之貨品，應另檢附經濟部出具之非屬戰略性高科技貨品鑑定報告，或該設備供應商之出口管制確認非屬戰略性高科技貨品文件。（三）屬戰略性高科技貨品列管項目者，除應檢附上述（一）文件外，應另依戰略性高科技貨品輸出入管理辦法相關規定辦理。二、輸出自非屬上述十二類半導體晶圓製造設備者，應檢附經濟部出具之非屬十二類半導體晶圓製造設備及非屬戰略性高科技貨品鑑定報告，申請輸出許可證。三、保稅區或課稅區或自由貿易港區間之半導體晶圓製造設備移轉，免辦理輸出許可證。

541

應檢附行政院原子能委員會同意文件

S01

輸往北韓敏感貨品清單內列管項目出口或再出口至北韓者，應向經濟部國際貿易局或經濟部委任或委託之機關（構）申請戰略性高科技貨品輸出許可證，並憑以報關出口。

S03

輸往伊朗敏感貨品清單內列管項目出口或再出口至伊朗者，應向經濟部國際貿易局或經濟部委任或委託之機關（構）申請戰略性高科技貨品輸出許可證，並憑以報關出口。